

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-066

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 合同类型：工程总承包合同；
- 合同金额：5.4 亿元；
- 对上市公司的影响：合同的签订和履行进一步巩固了子公司十一科技集成电路行业 EPC 领先地位，有利于未来新业务的开拓，本项目的实施将对公司 2016-2018 年度经营业绩产生积极影响；

2016 年 11 月 28 日，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）和重庆万国半导体科技有限公司（以下简称“重庆万国”）签署了《12 英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目设计、采购、施工总承包合同》，公告如下：

一、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

标的名称：重庆万国 12 英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目工程总承包；

标的金额：5.4 亿元；

（二）合同对方当事人情况。

本工程总承包合同的发包方是重庆万国半导体科技有限公司，具体情况如下：

- 1、公司名称：重庆万国半导体科技有限公司

2、统一社会信用代码/注册号：91500000MA5U5MLK89

3、法定代表人：MIKE FUSHING CHANG

重庆万国与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

二、合同主要条款

发包人：重庆万国半导体科技有限公司

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

1、工程名称：重庆万国 12 英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目工程总承包；

2、工程地点：重庆市两江新区水土高新技术产业园；

3、工程承包范围：本项目采用设计采购施工总承包模式，工程总承包企业按照合同约定承担工程项目的设计、采购、施工、项目管理、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，即交钥匙工程。

4、工程内容及规模：项目用地面积约 22 万平方米，建设内容包括 12 英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目及配套设施。

5、合同工期：整体工程预计于 2018 年 1 月 15 日前竣工，竣工日期以发包人签收的竣工验收接收证书的时间为准。

6、合同金额：合同金额 5.4 亿元，含设计费以及采购和施工总承包费用。

7、合同生效：本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章后，经签约双方董事会批准后自签订之日起生效。

四、合同履行对上市公司的影响

（一）合同金额 5.4 亿元，合同的签订和履行将对公司 2016-2018 年度经营业绩产生积极影响；

（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会对合同对方形成重大依赖。

（三）重庆万国控股股东美国 AOS（Alpha and Omega Semiconductor）是业内著名的半导体、晶圆制造、封装测试企业，合同的签订和履行进一步巩固了子公司十一科技在集成电路行业 EPC 领先地位，有利于未来新业务的开拓。

五、合同履行的风险分析

本合同为子公司十一科技日常经营合同，根据公司章程和内部相关制度，无需提交公司董事会或股东会审议；根据合同条款，本合同仍需提交十一科技和重庆万国双方的董事会批准。

项目的实施可能受到业主实际情况影响或不可抗力等因素所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度和资金回笼，防范风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、重庆万国项目《12英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目设计、采购、施工总承包合同》；

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日